

主要性能

- 测温范围 -20~1800℃ (分段)
- 高达 1KHz 的快速处理
- 最高 764×480 分辨率像素
- 毫秒级速度精确获取目标表面温度分布
- 自动追踪被测目标的冷热点
- 智能热成像分析软件

主要应用领域

金属热处理、钢包、回转窑胴体、皮带送料、浮法玻璃、冷热轧板、电机设备、配电柜母排等



标准包装

标配：主机（含 2.5m 电缆）、安装螺母、操作手册）

测量参数

型号	测量范围	光谱响应	最高像素
SEND-TI-M230	-20-900℃	7-14μm	640×480
SEND-TI-1M	450-1800℃	0.9-1.0μm	764×480
探测器	CMOS (15μm×15μm)		
测量精度	±1%(测量值)		
帧 频	128-1000Hz		
视场角	13° ...90° HFOV		
热灵敏度	40/80mK		
响应时间	4ms		
发射率	0.100-1.099		

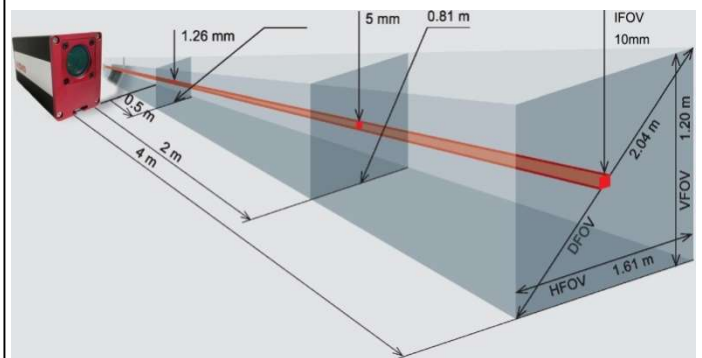
电气参数

模拟输出	1 路 4~20mA (可扩展)
数字输出	RS485(动态实时热成像视频)
输出阻抗	500 Ω (24VDC 时)
电 源	24VDC±20%

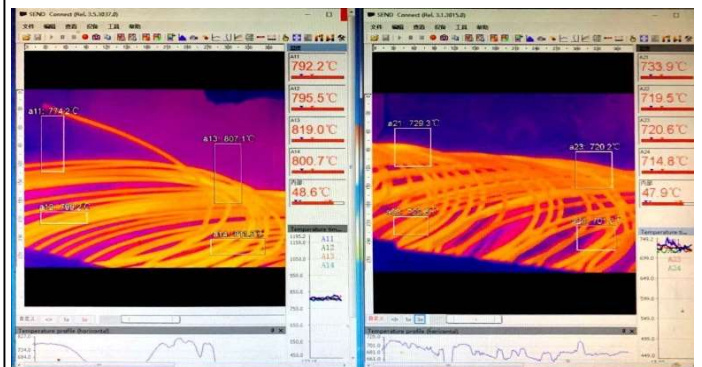
一般参数

环境等级	IP65 (NEMA-4)
环境温度	0~50℃
存储温度	-20~80℃
相对湿度	10~95%，不结露
尺 寸	72×95mm, L=194mm
重 量	1200g

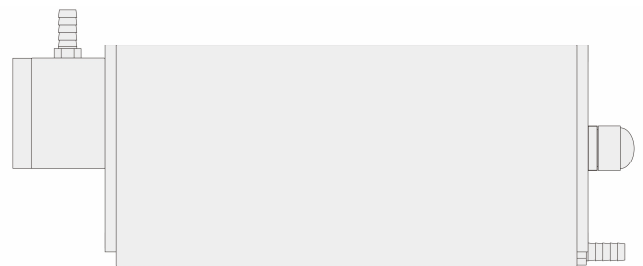
光学参数



现场热像图



保护套



选件

智能热成像分析软件、RS485 Modbus
扩展控制箱（专用电源、网络传输、输出信号转换）
空气吹扫器、冷却保护套、可调安装支架等